

[会員限定] 2025年度第3回 先端半導体パッケージWG研究会

【会場】大阪大学産業科学研究所
インキュベーション棟1階 講義室 (I-117)

2025年 受付13:00～
8/22 (金) 13:30～18:00

13:30-13:35 開会挨拶 菅沼克昭 所長・特任教授 大阪大学産業科学研究所F3D実装協働研究所

13:35-14:35 生成AIとチップレット時代における少量多品種対応の技術戦略



講師：若林秀樹氏 熊本大学 卓越教授

ハイブリッド

生成AIは、学習はクラウドで汎用GPUにより、推論はエッジ側で、アプリケーションに特化、「ビット・ワット」バランスの良い専用AIチップが注目される。専用チップ故に多品種少量になるのが採算面で課題だが、これにはヘテロジニアスも含めたチップレットとマスクレスで柔軟性に富むEB直描が有効である。モアザンムーア時代に大量生産過大設備投資競争から脱し、価値構造を変え、半導体のスマートで新たなビジネスモデルになろう。

14:35-15:35 フレキシブルエレクトロニクスによる生体計測技術



講師：植村隆文氏 大阪大学・産業科学研究所 准教授

ハイブリッド

本講演では、フレキシブルエレクトロニクス技術を用いたウェアラブル・インプラント生体計測技術の開発について紹介します。有機材料をベースとした柔軟で軽量の電子回路を用いることで、心電・脳波・汗中イオン成分などの微弱な生体信号を高精度に計測可能となります。特に、生体計測において課題となるノイズ(モーションアーティファクト)に対する対応など技術的要素についても詳述し、今後の展望についても解説します。

15:35-15:45 休憩・講師との名刺交換会

15:45-16:45 川崎重工業ロボット事業におけるAI活用への取組



講師：田頭 毅氏 川崎重工業株式会社 精密機械・ロボットカンパニー
ロボットディビジョン 技術総括部 制御開発部 部長

ハイブリッド

当社ロボット事業は現状・及び将来更に深刻化する労働力不足という社会課題に向き合い、ロボット活用領域を多角化しつつ、産業用、医療・ソーシャルロボット事業においてもAI活用への取組を積極的に進め、更なるロボットの拡大を目指している。本講演では当社ロボット事業のご紹介と共に現状のAI取組事例紹介と今後AI半導体への期待等についてご紹介する。

17:00-18:00 講師を交えた意見交換会

申し込み・問い合わせ 大阪大学 産業科学研究所 F3D実装協働研究所 先端半導体パッケージWG事務局
(TEL/FAX:06-6879-4295/E-mail:f3d@sanken.osaka-u.ac.jp)

主催:大阪大学 産業科学研究所 F3D実装協働研究所 後援:一般財団法人大阪大学産業科学研究協会